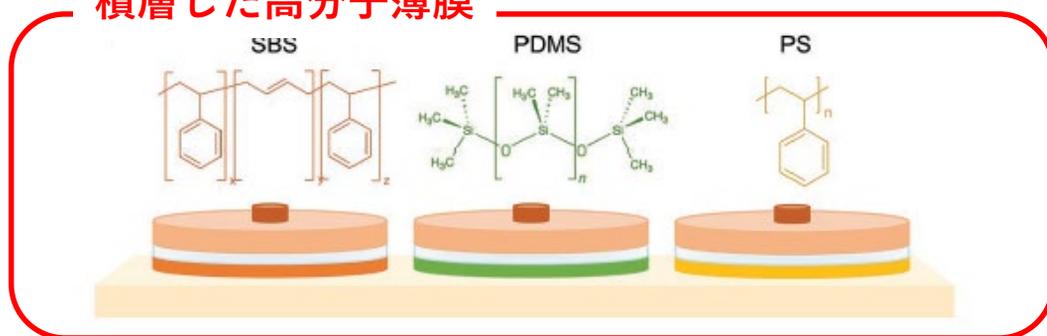


新技術の概要

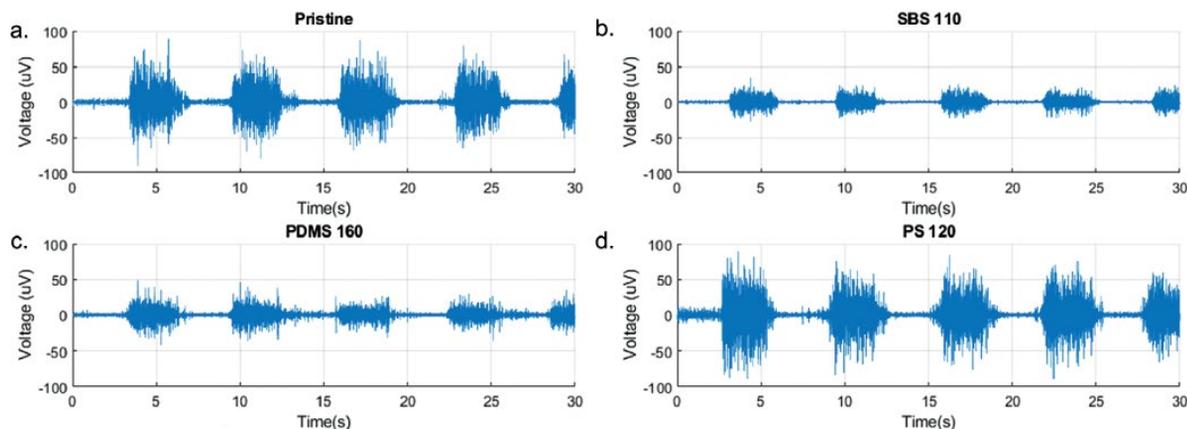
厚さ数10~2000 nmからなる高分子薄膜を生体デバイスの粘着ゲル層に積層

電極部の電極面に接着された粘着ゲル層の表面に積層された高分子薄膜により、生体との間で電気信号の授受能力を保持しつつ、粘着ゲル層の接着力を低減し、使用者への不快感を減らした生体デバイスを実現

積層した高分子薄膜



表面筋電位信号



出典：Toshinori Fujie et.al. Adv. Mater. Interfaces 2021, 2100213

本技術のアピールポイント

- 生体に違和感なく貼付可能

用途分野

- 生体デバイス

特許情報

発明の名称 低接着性生体デバイス
発明者 藤枝 俊宣 他
出願人 国立大学法人東京工業大学
出願 特願2020-117766 (出願日:2020/07/08)
公開 未公開
本学整理番号 20T035

